

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2024-044

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于对外投资进展以及增加投资额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资事项概述

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》，公司将通过新加坡子公司 OPTIZ PIONEER HOLDING PTE. LTD（以下简称“OPTIZ PIONEER”）在马来西亚投资成立子公司，旨在建设公司海外生产制造基地，提升公司生产制造与技术服务能力，更好贴近海外市场与客户需求，实现公司业务的持续性增长，有效推进公司国际市场拓展、技术研发、全球化生产投资的战略布局，计划投资金额为 5,000 万美元。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 28 日披露的《晶方科技关于投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：临 2024-030）。

二、对外投资进展情况

马来西亚子公司已完成注册设立工作，设立具体情况如下：

企业名称：WaferTek Solutions Sdn Bhd（以下简称“WaferTek”）

注册号码：202401031367 (1577216P)

注册地址：马来西亚、槟城

经营范围：从事二极管、晶体管及类似半导体器件、电子集成电路微型组件、其他电子应用组件及其他相关活动的经营等

投资额度：5,000 万美元

出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，由 OPTIZ PIONEER 持有 WaferTek 100% 股权

目前 WaferTek 正在积极商谈在马来西亚槟城的土地与厂房购买事宜，并处在购买协议的起草、签署进程中。协议签署完成后，公司后续将积极推进交易相关的交割手续。

三、增加投资额度情况

（一）增加投资额度基本情况

为有效推进公司马来西亚投资项目的进展，公司计划对拟购买的土地厂房进行布局设计与改造，并实施无尘室装修、厂务系统以及水、电、气等基础设施的建设与完善，为此公司拟计划向马来西亚子公司增加 3,000 万美元投资额度，资金来源为自有资金。

（二）董事会审议情况

2024 年 10 月 29 日公司召开第五届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于对外投资进展以及增加投资额度的议案》。本次增加投资事项在公司董事会授权范围之内，无需提交公司股东大会审议。

本次增加投资额度不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、本次投资对上市公司的影响

本次投资旨在积极推进公司马来西亚生产制造基地的建设，提升公司生产制造与技术服务能力，更好贴近海外市场与客户需求，实现公司业务的持续性增长，以及国际市场拓展、技术研发、全球化生产投资的战略布局。

五、本次投资的风险分析

马来西亚拥有良好的商业环境，槟城是马来西亚最重要的制造业中心之一，在电子、半导体、汽车零部件等领域具备良好的产业与人才基础。受宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等诸多因素影响，本次投资预期的实现也相应存在不确定性的风险。公司将努力推进全球业务、生产制造能力建设、项目拓展等事项的动态布局，整合各项资源，做好相关风险的管理工作，切实有效地降低投

资风险。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2024年10月30日